

納入仕様書 (SPECIFICATION)

1. 目的 (Purpose)
2. 適用範囲 (Applicable Product)
3. 生産地 (Production Location)
4. 製品規格 (Product Specification)
5. 梱包／表示 (Packing/Marking)
6. 信頼性 (Reliability)
7. 注意事項 (Cautions)
8. 保証 (Assurance)
9. 不良品の処置 (Treatment of Defective Products)
10. その他 (Other)

品名(Product): ASA COLOR LED
品番(Part Number): NFSC172C+CAP series

受領印欄 (Receipt Acknowledgement) この書類を受領しました。(We have duly received this specification.) 年 月 日 (Date YMD)				
部署名 (Division)				
担当者印 (Responsible Party Seal)				

製造者名 (Manufacturer:) 株式会社朝日ラバー (ASAHI RUBBER INC.)				
品質管理 (Quality Control)	生産 (Production Dept.)	営業 (Sales Dept.)	技術 (Engineering Dept.)	作成 (Prepared by)

改定 (Revision)	年 月 日
実施 (In Effect)	年 月 日
制定 (Draft)	2022 年 8 月 10 日

1. 目的 (Purpose)

〇〇〇〇株式会社様(以下甲という)に株式会社朝日ラバー(以下乙という)が納入する ASA COLOR LED (以下本製品という)について、業務処理を円滑に行うことを目的として、この納入仕様書を設定する。

(Regarding ASA COLOR LED that ASAHI RUBBER INC., supply to 〇〇〇〇., we establish this specification in order to facilitate delivery operation.)

2. 適用範囲 (Applicable Product)

本仕様書は乙が、甲に納入する本製品について適用する。

(This specification applies to ASA COLOR LED that we supply to 〇〇〇〇.)

3. 生産地 (Production Location)

生産場所(Country of Origin) : 日本(JAPAN)

事業所名(Production Facility) : 株式会社 朝日ラバー白河工場(ASAHI RUBBER INC., Shirakawa Factory)

住所(Facility Address) : 福島県白河市萱根月ノ入1番地 21 〒961-0004

(1-21, Tsukinoiri, Kayane, Shirakawa-shi, Fukushima, 961-0004, JAPAN)

4. 製品規格 (Product Specifications)

本製品は、日亜化学工業株式会社製 青色 LED NFSC172C に、シリコーンゴムフィルターを接着した製品である。

(This product consists of NICHIA CORPORATION blue LED NFSC172C and silicone rubber cap of ASAHI RUBBER INC.)

(1) 絶対最大定格 (Absolute Maximum Ratings)

項目 (Item)	記号 (Symbol)	最大定格 (Absolute Maximum Rating)	単位 (Unit)
順電流 (Forward Current)	I_F	250	mA
パルス順電流 (Pulse Forward Current)	I_{FP}	350	mA
静電耐圧(HBM) (ESD Withstand Voltage (HBM))	V_{ESD}	8	kV
逆方向許容電流 (Allowable Reverse Current)	I_R	85	mA
許容損失 (Power Dissipation)	P_D	850	mW
動作温度 (Operating Temperature)	T_{opr}	-40~125	°C
保存温度 (Storage Temperature)	T_{stg}	-40~125	°C
ジャンクション温度 (Junction Temperature)	T_J	150	°C

* $T_S=25^\circ\text{C}$ での値です。(Absolute Maximum Ratings at $T_S=25^\circ\text{C}$)

* I_{FP} 条件は、パルス幅 10ms 以下、デューティー比は 10%以下です。

(I_{FP} conditions with pulse width $\leq 10\text{ms}$ and duty cycle $\leq 10\%$.)

*静電耐圧(HBM)は ANSI/ESDA/JESEC JS-001 のクラス 3B です。

(HBM ESD Component Classification Level of the LEDs: Class 3B For more details, see ANSI/ESDA/JEDEC JS-001.)

(2) 初期電気特性/特性 (Initial Electrical / Optical Characteristics)

項目 (Item)	ランク (Rank)	記号 (Symbol)	条件 (Condition)	標準 (Typ)	最小 (Min)	最大 (Max)	単位 (Unit)
順電圧 (Forward voltage)	—	V_F	$I_F=150mA$	3.00	2.80	3.25	V
光束 (Luminous Flux)	—	Φ_v	$I_F=150mA$	別途発行の光学特性規格表による (According to the optical characteristics specifications issued separately.)			lm

*順電圧は±0.05Vの公差があります。(Forward Voltage Tolerance: ±0.05V)

*光束範囲につきましては±10%の公差があります。(Luminous Flux Tolerance: ±10%)

(3) 色度範囲 (Chromaticity Range)

項目 (Item)	記号 (Symbol)	条件 (Condition)	標準 (Typ)	色度範囲 (Chromaticity Range Coordinates)
色度 (Chromaticity)	x	$I_F=150mA$	別途発行の光学特性規格表による (According to the optical characteristics specifications issued separately.)	
	y	$I_F=150mA$		

*色度座標は、CIE 1931 色度図に基づくものとします。

(Chromaticity Coordinates as per CIE 1931 Chromaticity Chart.)

*色度は、±0.01の公差があります。

(Chromaticity Coordinate Tolerance: ±0.01.)

(4) デイレーティング特性 (Derating Characteristics)

別紙のデイレーティング特性を参照下さい。

(Please refer to the attached sheet of same title.)

(5) 電流温度特性 (Forward Current Characteristics / Temperature Characteristics)

別紙の電流温度特性を参照下さい。

(Please refer to the attached sheet of same title.)

(6) 外形寸法／材質 (Outline Dimensions and Materials)

別紙の外形寸法／材質を参照下さい。

(Please refer to the attached sheet of same title.)

(7) キャップ材質 (Rubber Cap Characteristics)

シリコンゴム (Silicone rubber) ASR756,

シリコン系接着剤 (Silicone adhesive)

ジメチルポリシロキサン D4～D10 残留量 50ppm以下

(Residual volume of dimethylpolysiloxane D4～D10: less than 50ppm)

5. 梱包／表示 (Packing / Marking)

別紙のテーピング仕様図、梱包仕様図を参照下さい。

テーピングリール及びアルミ防湿袋には、以下の表示をします。

図番、ロット番号、ランク名、数量

(Please refer to attached sheet of same title.)

(Reels are shipped with desiccants in heat-sealed moisture-proof bags.

The label on each packing unit shows the following information: Part Number, Lot Number, Rank, and Quantities.)

本製品はテーピングしたのち、輸送の衝撃から保護するためにダンボールで梱包します。

(Products shipped on tape and reel are packed in a moisture-proof bag.

They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation.)

取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因となりますので注意して下さい。

(Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products.)

ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。

(Do not expose to water, the box is not water-resistant.)

輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態、あるいは同等の梱包状態を行って下さい。

(Using the original package material or equivalent in transit is recommended.)

6. 信頼性 (Reliability)

(1) 試験項目と試験結果 (Tests and Results)

試験項目 (Test)	試験方法 (Reference Standard)	試験条件 (Test Conditions)	試験時間 (Test Duration)	故障判定 基準 No. (Failure Criteria #)	故障数/試験数 (Units Failed/Tested)
はんだ耐熱性 (リフローはんだ) Resistance to Soldering Heat (Reflow Soldering)	JEITA ED-4701 300 301	$T_{\text{slid}}=260^{\circ}\text{C}$, 10 秒, 2 回 ($T_{\text{slid}}=260^{\circ}\text{C}$, 10sec., 2reflows Precondition: 30°C , 70%RH, 168hr)	—	#1	0/22
はんだ付け性 (リフローはんだ) Solderability (Reflow Soldering)	JEITA ED-4701 303 303A	$T_{\text{slid}}=245\pm 5^{\circ}\text{C}$, 5 秒 鉛フリーはんだ (Sn-3.0Ag-0.5Cu) ($T_{\text{SLD}}=245\pm 5^{\circ}\text{C}$, 5sec, Lead-free Solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu))	—	#2	0/22
熱衝撃(気相) Thermal Shock (Air to Air)	—	-40°C (15 分) \sim 125°C (15 分) (-40°C to 125°C , 15min dwell)	100 サイクル (100 cycles)	#1	0/22
湿湿度サイクル (Moisture Ristance (Cyclic))	JEITA ED-4701 200 203	$25^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}\sim -10^{\circ}\text{C}$, 90%RH 24 時間/1 サイクル(24hr per cycle)	10 サイクル (10 cycles)	#1	0/22
高温保存 (High Temperature Storage)	JEITA ED-4701 200 201	$T_{\text{A}}=125^{\circ}\text{C}$	1000 時間 (1000 hours.)	#1	0/22
高温高湿保存 (Temperature Humidity Storage)	JEITA ED-4701 100 103	$T_{\text{A}}=85^{\circ}\text{C}$, RH=85%	1000 時間 (1000 hours.)	#1	0/22
低温保存 (Low Temperature Storage)	JEITA ED-4701 200 202	$T_{\text{A}}=-40^{\circ}\text{C}$	1000 時間 (1000 hours.)	#1	0/22
連続動作 (Room Temperature Operating Life)	—	$T_{\text{A}}=25^{\circ}\text{C}$, $I_{\text{F}}=250\text{mA}$ 試験基板は下記注記参照 (Test board: See NOTES below)	1000 時間 (1000 hours.)	#1	0/22
高温連続動作 (High Temperature Operating Life)	—	$T_{\text{A}}=125^{\circ}\text{C}$, $I_{\text{F}}=80\text{mA}$ 試験基板は下記注記参照 (Test board: See NOTES below)	1000 時間 (1000 hours.)	#1	0/22
高温高湿連続動作 (Temperature Humidity Operating Life)	—	85°C , RH=85%, $I_{\text{F}}=200\text{mA}$ 試験基板は下記注記参照 (Test board: See NOTES below)	1000 時間 (1000 hours.)	#1	0/22
低温連続動作 (Low Temperature Operating Life)	—	$T_{\text{A}}=-40^{\circ}\text{C}$, $I_{\text{F}}=250\text{mA}$ 試験基板は下記注記参照 (Test board: See NOTES below)	1000 時間 (1000 hours.)	#1	0/22
静電破壊 (Electrostatic Discharge)	ANSI/ESDA/ JEDEC JS-001	HBM, 8kV, 1.5k Ω , 100pF, 順逆 1 回 (HBM, 8kV, 1.5k Ω , 100pF, 1pulses, alternately positive or negative)	-	#1	0/22

注記: (Notes:)

1) 試験基板: FR4 $t=1.6\text{mm}$ 、銅箔 $t=0.07\text{mm}$ 、熱抵抗 $R_{\theta\text{JA}}\approx 95^{\circ}\text{C}/\text{W}$

(Test board: FR4 board thickness=1.6mm, copper layer thickness=0.07mm, $R_{\theta\text{JA}}\approx 95^{\circ}\text{C}/\text{W}$)

2) 測定は LED が常温に戻ってから行います。

(Measurements are performed after allowing the LEDs to return to room temperature.)

(2) 故障判定基準 (Failure Criteria)

基準No. (Criteria #)	特性項目 (Items)	試験条件 (Conditions)	判定基準 (Failure Criteria)
#1	順電圧(V_F) (Forward Voltage (V_F))	$I_F=150\text{mA}$	$>$ 初期値 $\times 1.1$ ($>$ Initial value $\times 1.1$)
	光束 (Φ_v) (Luminous Flux(Φ_v))	$I_F=150\text{mA}$	$<$ 初期値 $\times 0.7$ ($<$ Initial value $\times 0.7$)
	接着性(Adhesiveness)	90° 剥離(90°Peel)	剥離強度 $<0.5\text{N}$ (Peel strength $<0.5\text{N}$)
#2	はんだぬれ性(Solderability)	-	はんだぬれ面積率が 95%未満 (Less Than 95% Solder Coverage)

7. 注意事項 (Cautions)

(1) 保管 (Storage)

	条件(Conditions)	温度(Temperature)	湿度(Humidity)	期間(Time)
保管 (Storage)	アルミ防湿袋開封前 (Before Opening Aluminum Bag)	30°C以下 ($\leq 30^\circ\text{C}$)	90%RH 以下 ($\leq 90\%RH$)	納入日より 1 年以内 (Within 1 Year from Delivery Date)
	アルミ防湿袋開封後 (After Opening Aluminum Bag)	30°C以下 ($\leq 30^\circ\text{C}$)	70%RH 以下 ($\leq 70\%RH$)	168 時間以内 ($\leq 168\text{hours}$)
	ベーキング (Baking)	60 \pm 5°C	-	24 時間以上 ($\geq 24\text{ hours}$)

- 本製品は、MSL3 に相当します。MSL については IPC/JEDEC STD-020 をご確認ください。
(Product complies with JEDEC MSL3 or equivalent. See IPC/JEDEC STD-020 for moisture-sensitivity details.)
- 本製品は、パッケージに吸収された水分がはんだ付け時の熱で気化膨張することにより、界面の剥離が発生し光学的劣化を起こす可能性があります。そのためお客様にて実装するまでの、吸湿量を最小限に抑えるため防湿梱包を実施しております。アルミ防湿袋に入っているシリカゲルは吸湿が進むと青色から赤色へ変色します。
(This LED uses a package that could absorb moisture; if the package absorbs moisture and is exposed to heat during soldering, it may cause the moisture to vaporize and the package to expand and the resulting pressure may cause internal delamination. This may cause the optical characteristics to degrade. To minimize moisture absorption in storage/transit, moisture-proof aluminum bags are used for the LEDs with a silica gel packet to absorb any air moisture in the bag. The silica gel beads turn blue to red as they absorb moisture.)
- アルミ防湿袋の開封後は上記の条件を越えないようにはんだ付けを完了下さい。万一未使用の LED が残った場合は、シリカゲル入り密閉容器等で保管下さい。なお当社防湿袋に戻し、再封印することを推奨します。
(After opening the moisture-proof aluminum bag, the products should go through the soldering process within the range of the conditions stated above. Unused remaining LEDs should be stored with silica gel desiccants in a hermetically sealed container, preferably the original moisture-proof bags for storage.)
- 保管期限を過ぎた場合には、ベーキング処理を施して下さい。また、保管期間内に同封してあるシリカゲルの青色が無くなった場合も、同様にベーキングをお願いします。ベーキングは1回までとします。
(If the "After Opening" storage time has been exceeded or any pink silica gel beads are found, ensure that the LED are baked before use. Baking should only be done once.)
- 電極部分は、金メッキが施されております。腐食性ガスを含む雰囲気さらされると、メッキ表面が変質し、はんだ付け性の際に問題が生じる事があります。保管時は密閉容器等で保管して下さい。なお当社防湿袋に戻し、再封印することを推奨します。
(This LED has gold-plated electrodes. If the LEDs are exposed to a corrosive environment, it may cause the plated surface to tarnish causing issues (i.e. solderability). Ensure that when storing LEDs, a hermetically sealed container is used. Asahi Rubber recommends placing them back to the original moisture-proof bag and reseal it.)

- 実機に使用する部材(パッキン、接着剤など)については、メッキ表面への影響を考慮して、硫黄成分を含有しているものの使用を避けて下さい。メッキの極端な腐食や表面異常は、導通・接続不良に繋がる可能性があります。また、パッキンを使用する場合は、シリコンゴム材質のものを推奨します。その際、低分子量のシロキサンによる機器の接点不良に注意して下さい。

(To prevent substances/gases from affecting the plated surface, ensure that the parts/materials used with the LEDs in the same assembly/system do not contain sulfur (e.g. gasket/seal, adhesive, etc.). If the plating is contaminated, it may cause issues (e.g. electric connection failures). If a gasket/seal is used, silicone rubber gaskets/seals are recommended; ensure that this use of silicone does not result in issues (e.g. electrical connection failures) caused by low molecular weight volatile siloxane.)

- 急激な温度変化のある場所では、結露が起こりますので温度変化の少ない場所に保管して下さい。
(To avoid condensation, the LEDs must not be stored in areas where temperature and humidity fluctuate greatly.)
- 埃の多い環境での保管は避けて下さい。
(Do not store the LEDs in a dusty environment.)
- 直射日光や室温を超えるような環境に長期間さらさないで下さい。
(Do not expose the LEDs to direct sunlight and/or an environment over a long period of time where the temperature is higher than normal room temperature.)

(2) 使用方法 (Directions for Use)

- LED 毎に絶対最大定格を超えないように回路設計を行って下さい。LED 毎に定電流駆動することを推奨致します。また定電圧駆動する場合は、(A)の回路はLEDの順電圧の影響によりLEDに流れる電流がばらつく可能性がありますので、(B)の回路を推奨します。

(The circuit must be designed to ensure that the Absolute Maximum Ratings are not exceeded for each LED. The LEDs should be operated at a constant current per LED. In the case of operating at a constant voltage, Circuit B is recommended. If Circuit A is used, it may cause the currents flowing through the LEDs to vary due to the variation in the forward voltage characteristics of the LEDs on the circuit.)



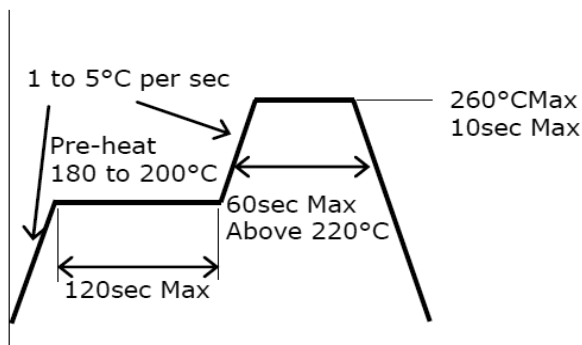
- 本製品は、順方向電流駆動でご使用下さい。また、非点灯時には順逆とも電圧がかからないように配慮下さい。特に逆電圧が連続的に加わる状態は、マイグレーションを発生させる可能性があり、素子にダメージを与える場合がありますので避けて下さい。長時間使用しない場合は、安全のために必ず主電源スイッチを切して下さい。
(This LED is designed to be operated at a forward current. Ensure that no voltage is applied to the LED in the forward/reverse direction while the LED is off. If the LEDs are used in an environment where reverse voltages are applied to the LED continuously, it may cause electrochemical migration to occur causing the LED to be damaged. When not in use for a long period of time, the system's power should be turned off to ensure that there are no issues/damage.)
- 本製品は LED の諸特性が安定する定格電流の 10%以上でご使用されることを推奨します。
(It is recommended to operate the LEDs at current greater than 10% of the rated current to stabilize the LED characteristics.)
- 雷サージなどの過電圧が LED に加わらないようにして下さい。
(Ensure that transient excessive voltages (e.g. lighting surge) are not applied to the LEDs.)
- 屋外で使用される場合は、十分な防水対策、湿度対策、塩害対策を施してご使用下さい。
(If the LEDs are used for outdoor applications, ensure that necessary measures are taken (e.g. protecting the LEDs from water/salt damage and high humidity).)

(3) 取り扱い上の注意 (Handling Precautions)

- 素手で本製品を取り扱わないで下さい。表面が汚れ、光学特性に影響を及ぼすことがあります。また場合によっては、製品の変形や断線が起こり、不灯の原因になることがあります。
(Do not handle the LEDs bare hands:
 - this may contaminate the LED surface and have an effect on the optical characteristics,
 - this may cause the LED to deform and/or the wire to break causing a catastrophic failure (i.e. the LED not to illuminate).)
- ピンセットで本製品を取り扱う場合は、製品への過度な圧力をかけないようにして下さい。樹脂部の傷、欠け、剥がれ、製品の変形や断線が起こり、不灯の原因となります。
(Ensure that when handling the LEDs with tweezers, excessive force is not applied to the LED. Otherwise, it may cause damage to the resin (e.g. cut, scratch, chip, crack, delamination and deformation) and the wire to break causing a catastrophic failure (i.e. the LED not to illuminate).)
- 本製品を落下させてしまった場合には、製品の変形などが発生することがありますのでご注意下さい。
(Dropping may cause damage to the LED (e.g. deformation).)
- 本製品の実装後に基板は積み重ねしないで下さい。実装した基板を重ねると、基板が樹脂部に衝撃を与え樹脂部の傷、欠け、剥がれ、変形・断線、LED 剥がれが発生し、不灯の原因になります。
(Do not stack assembled PCBs together. Otherwise, it may cause damage to the resin (e.g. cut, scratch, chip, crack, delamination and deformation) and the wire to break causing a catastrophic failure (i.e. the LED not to illuminate).)

(4) はんだ付け (Soldering)

- リフロー推奨条件 (Pb フリーはんだ使用時)
(Recommended Reflow Soldering Condition (Lead-free Solder))



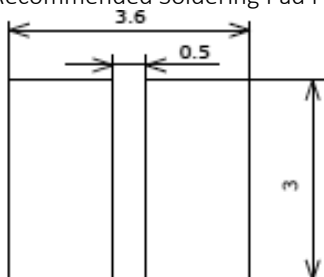
- 手はんだ推奨条件 (Recommended Hand Soldering Condition)

コテ温度(Temperature)	350°C以下(350°C Max)
時間(Soldering Time)	3 秒以内(3sec Max)

- 推奨取り付けパターン(Recommended Soldering Pad Pattern)

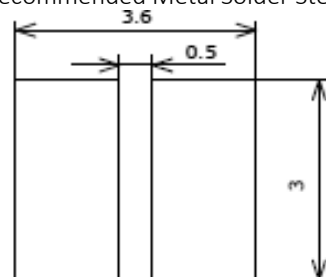
・推奨取り付けパターン

(Recommended Soldering Pad Pattern)



・推奨メタルマスク開口パターン

(Recommended Metal Solder Stencil Aperture)



(単位 Unit: mm)

- 本製品は、リフロー対応品です。ディップはんだについては保証できません。
(This LED is designed to be reflow soldered on to a PCB. If dip soldered, Asahi Rubber will not guarantee its reliability.)
- リフローはんだは2回まで、手はんだは1回として下さい。
(Reflow soldering must not be performed more than twice. Hand soldering must not be performed more than once.)
- ピーク温度からの冷却温度勾配が緩やかになるように配慮して、急冷却を避けて下さい。
(When cooling the LEDs from the peak temperature a gradual cooling slope is recommended; do not cool the LEDs rapidly.)
- 大気リフローの場合、リフロー時の熱や雰囲気の影響により、光学的劣化を起こすことがあります。リフローに際しては、窒素リフローを推奨します。
(During reflow soldering, the heat and atmosphere in the reflow oven may cause the optical characteristics to degrade. In particular, reflow soldering performed with an air atmosphere may have a greater negative effect on the optical characteristics than if a nitrogen atmosphere is used; Asahi Rubber recommends using a nitrogen reflow atmosphere.)
- 本製品は封止材料にシリコン樹脂を用いているため、上面の封止部が柔らかく、力が加わると傷、欠け、剥がれ、製品の変形、断線や信頼性に影響を及ぼす恐れがあります。封止部に圧力を加えないで下さい。
(This LED uses a silicone resin for the encapsulating resin; the silicone resin is soft. If pressure is applied to the silicone resin, it may cause the resin to be damaged, chipped, delaminated and/or deformed. If the resin is damaged, chipped, delaminated and/or deformed, it may cause the wire to break causing a catastrophic failure (i.e. the LED not to illuminate) and/or reliability issues (e.g. the LED to corrode and/or to become dimmer, the color/directivity to change, etc.). Ensure that pressure is not applied to the encapsulating resin.)
- 基本的にははんだの取り付け後の修正は行わないで下さい。やむを得ず修正する場合は双頭式のはんだコテを使用して下さい。また、事前に修正による特性の劣化のなきことを確認の上行って下さい。
(Once the LEDs have been soldered to a PCB, it should not be repaired/reworked. If it must be done, using a double-head soldering iron is strongly recommended. Ensure that sufficient verification is performed prior to use to ensure that the repair/rework has not caused the LED characteristics to deteriorate.)
- はんだ付け時、加熱された状態でLEDにストレスを加えないで下さい。
(When soldering, do not apply stress to the LED while the LED is hot.)
- 実装機を使用する場合は、本製品にあった吸着ノズルを選定下さい。発光面サイズより小径のノズルを使用しますと発光面を傷つけると共にLEDが不灯に至る可能性があります。
(When using an automatic pick-and-place machine, choose an appropriate nozzle for this LED. Using a pick-and-place nozzle with a smaller diameter than the size of the LED's emitting surface will cause damage to the emitting surface causing a catastrophic failure (i.e. the LED not to illuminate).)
- あくまで推奨ランドはLEDを問題無く取り付けられるランドサイズとなっております。高密度実装などで実装精度が必要となる場合は、それに適したランド形状を検討下さい。
(The soldering pad pattern above is a general recommendation for LEDs to be mounted without issues; if a high degree of precision is required for the chosen application (i.e. high-density mounting), ensure that the soldering pad pattern is optimized.)
- はんだの種類はリフロー温度や手はんだ温度を加味して選定下さい。
(Consider factors such as the reflow soldering temperature, hand soldering temperature, etc. when choosing the solder.)
- フラックスを使用する場合はノンハロゲンタイプを推奨します。また、LEDに直接フラックスがかかるような工程設計は行わないで下さい。
(When flux is used, it should be a halogen free flux. Ensure that the manufacturing process is not designed in a manner where the flux will come in contact with the LEDs.)
- 取り付けパターンに対して、はんだ種類及びはんだ塗布量が問題ないことを事前に確認して下さい。
(Ensure that there are no issues with the type and amount of solder that is being used.)

(5) 設計上の注意 (Design Considerations)

- LEDを基板にはんだ付けした後の基板分割工程などで基板が曲がると、パッケージ割れが発生することがありますので基板のたわみやねじりに対して極カストレスの加わらないようなLED配置にしてください。
(If the LEDs are soldered to a PCB and the PCB assembly is bent (e.g. PCB depaneling process), it may cause the LED package to break. The PCB layout should be designed to minimize the mechanical stress on the LEDs when the PCB assembly is bent/warped.)
- 基板分割部ではLEDの取り付け位置によって機械的ストレスが変化しますので、最もストレスが加わらないような位置に配置してください。
(The amount of mechanical stress exerted on the LED from depaneling may vary depending on the LED position/orientation on the PCB assembly (e.g. especially in areas near V-groove scores). The PCB layout should be designed to minimize the mechanical stress on the LEDs when the PCB is separated into individual PCB assemblies.)
- 基板分割時は、手割を避け、専用治具にて行ってください。
(To separate a PCB populated with the LEDs, use a specially designed tool. Do not break the PCB by hand.)
- LED周辺で使用する部材(筐体、パッキン、接着剤、2次レンズ、レンズカバーなど)から放出された揮発性有機化合物は、LEDの発光面を透過する可能性があります。特に密閉に近い状態では、これらの揮発性有機化合物が熱や光子エネルギーにさらされると変色が起こりLEDの光出力が大幅に低下したり、色ズレが発生する可能性があります。また、空気の循環をよくすることで、光出力の低下や色ズレが改善されることがあります。予め実機点灯試験による光学評価で異常なきことの確認をお願いします。
(Volatile organic compounds that have been released from materials present around the LEDs (e.g. housing, gasket/seal, adhesive, secondary lens, lens cover, etc.) may penetrate the LED emitting surface. If the LEDs are being used in a hermetically/near-hermetically sealed environment, these volatile compounds can discolor after being exposed to heat and/or photon energy and it may greatly reduce the LED light output and/or color shift. In this case, ventilating the environment may improve the reduction in light output and/or color shift. Perform a light-up test of the chosen application for optical evaluation prior to use to ensure that there are no issues, this test should be performed taking into consideration the conditions/environments in which the end-product containing these LEDs will actually be used.)

(6) 静電気に対する取り扱い (Electrostatic Discharge (ESD))

- 本製品は静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。取り扱いに際しては、以下の例を参考に静電気対策を十分行ってください。
リストストラップ、導電性衣類、導電靴、導電性床材等による電荷の除去
作業区域内の装置、治具等の接地による電荷の除去
導電性材料による作業台、保管棚等の設置
(This LED is sensitive to transient excessive voltage (e.g. ESD, lightning surge). If this excessive voltage occurs in the circuit, it may cause the LED to be damaged causing issues (e.g. the LED to have a reduction in the radiant flux or not to illuminate [i.e. catastrophic failure]).
Ensure that when handling the LEDs, necessary measures are taken to protect them from an ESD discharge. The following examples are recommended measures to eliminate the charge:
 - Grounded wrist strap, ESD footwear, clothes, and floors
 - Grounded workstation equipment and tools
 - ESD table/shelf mat made of conductive materials)
- 使用機器(はんだコテなど)、治具、装置類や作業区域内は適切に接地をしてください。また、実装される機器等についてもサージ対策の実施を推奨します。
(Ensure that all necessary measures are taken to prevent the LEDs being from exposed to transient excessive voltages (e.g. ESD, lightning surge).
 - tools (e.g. soldering irons), jigs, and machines that are used are properly grounded
 - appropriate ESD materials/equipment are used in the work area
 - the system/assembly is designed to provide ESD protection for the LEDs.

- 治具、装置類にガラスやプラスチックなどの絶縁体を使用される場合は以下の例を参考に対策を十分行って下さい。

導電性材料による導電化
 加湿による帯電防止
 除電器(イオナイザ)による電荷の中和

(If the tool/ equipment used is an insulator (e.g. glass cover, plastic, etc.), ensure that necessary measures have been taken to protect the LED from transient excessive voltages (e.g. ESD). The following examples are recommended measures to eliminate the charge:

- Dissipating static charge with conductive materials
- Preventing charge generation with moisture
- Neutralizing the charge with ionizers)

- 本製品を機器に実装後、特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くようお願いいたします。電流を下げて(1mA 以下推奨)順電圧検査又は発光検査を実施することで、損傷の有無は容易に検出できます。

(To detect if an LED was damaged by transient excess voltages (i.e. an ESD event during the system's assembly process), perform a characteristics inspection (e.g. forward voltage measurement, light-up test) at low current ($\leq 1\text{mA}$).

- 損傷したLEDには、順方向の立ち上がり電圧が低下する、低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。

不合格判定基準: ($V_F < 2.0\text{V}$ at $I_F = 0.5\text{mA}$)

(Failure Criteria: $V_F < 2.0\text{V}$ at $I_F = 0.5\text{mA}$)

If the LED is damaged by transient excess voltages (e.g. ESD), it will cause:

- the Forward voltage (V_F) to decrease
- the LED not to illuminate at a low current)

(7) 熱の発生 (Thermal Management)

- 本製品をご使用の際は、熱の発生を考慮して下さい。通電時の素子の温度上昇は、実装する基板の熱抵抗や本製品の集合状態により変化します。熱の集中を避け、本製品周囲の環境条件により最大ジャンクション温度(T_J)を超えることがないように配慮して下さい。

(The Absolute Maximum Junction Temperature (T_J) must not be exceeded under any circumstances. The increase in the temperature of an LED while in operation may vary depending on the PCB thermal resistance and the density of LEDs on the PCB assembly. Ensure that when using the LEDs for the chosen application, heat is not concentrated in an area and properly managed in the system/assembly.)

- 本製品周囲の温度条件(T_A)により使用電流を決め放熱等の処理を施して下さい。
 (The operating current should be determined by considering the temperature conditions surrounding the LED (i.e. T_A). Ensure that when operating the LED, proper measures are taken to dissipate the heat.)

- 温度についての関係は、次の2つの式で表されます。

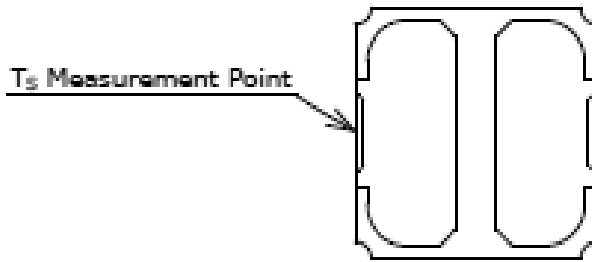
$$1) T_J = T_A + R_{\theta JA} \cdot W \quad 2) T_J = T_S + R_{\theta JS} \cdot W$$

* T_J =ジャンクション温度: °C、 T_A =周囲温度: °C
 T_S =はんだ接合部温度(カソード側): °C
 $R_{\theta JA}$ =ダイスからの周囲空気までの熱抵抗: °C/W
 $R_{\theta JS}$ =ダイスから T_S 測定ポイントまでの熱抵抗: °C/W
 W =投入電力($I_F \times V_F$): W

(The following two equations can be used to calculate the LED junction temperature:

$$1) T_J = T_A + R_{\theta JA} \cdot W \quad 2) T_J = T_S + R_{\theta JS} \cdot W$$

* T_J =LED Junction Temperature: °C、 T_A =Ambient Temperature: °C
 T_S =Soldering Temperature: °C
 $R_{\theta JA}$ =Thermal Resistance from junction to Ambient: °C/W
 $R_{\theta JS}$ =Thermal Resistance from Junction to T_S Measurement point: °C/W
 W =Input Power($I_F \times V_F$): W)



(8) 洗浄 (Cleaning)

- ぬれた雑巾、ベンジン、シンナーなどで LED を拭かないで下さい。
(Do not clean the LEDs with water, benzine and/or thinner.)
- 洗浄する場合は、イソプロピルアルコールを使用して下さい。その他の洗浄剤の使用にあたっては、パッケージ及び樹脂が侵される、またはキャップが膨潤する場合がありますので、問題のないことを十分確認の上での使用をお願い致します。フロン系溶剤については、世界的に使用が規制されています。
(To clean the LEDs, use isopropyl alcohol (IPA). If another solvent is used, it may cause the LED package/resin to be damaged causing issues; ensure that sufficient verification is performed prior to use. Additionally, ensure that the solvent being used does not cause any other issues (e.g. CFC-based solvents are heavily regulated.)
- LED に汚れが付着した場合にはイソプロピルアルコールを布に付けて良く絞って汚れを拭き取って下さい。
(If an LED is contaminated (e.g. dust/dirt), use a cloth soaked with isopropyl alcohol (IPA). Ensure that the cloth is firmly squeezed before wiping the LED.)
- 超音波洗浄は、基本的に行なわないで下さい。やむをえず行なう場合は、発振出力や基板の取り付け方により LED への影響が異なりますので、予め実使用状態で異常のない事を確認の上実施して下さい。
(Do not clean the LEDs with an ultrasonic cleaner. If cleaning must be done, ensure that sufficient verification is performed by using a finished assembly with LEDs to determine cleaning conditions (e.g. ultrasonic power, LED position on the PCB assembly) that do not cause an issue.)

(9) 目の安全性 (Eye Safety)

- 2006 年に国際電気委員会(IEC)からランプ及びランプシステムの光生物学的安全性に関する規格 IEC 62471 が発行され、LED もこの規格の適用範囲に含められました。
一方、2001 年に発行されたレーザー製品の安全に関する規格 IEC 60825-1 Edition1.2 において、LED が適用範囲に含まれていましたが、2007 年に改定された IEC 60825-1 Edition2.0 で LED が適用除外されました。但し、国や地域によっては、依然として IEC 60825-1 Edition1.2 と同等規格を採用し、LED が適用範囲に含まれています。これらの国や地域向けには、ご注意ください。
IEC 62471 によって分類される LED のリスクグループは、放射束や発光スペクトル、指向性などによって異なり、特に青色成分を含む高出力ではリスクグループ 2 に相当する場合があります。LED の出力を上げたり、LED からの光を光学機器にて集光したりするなどした状態で直視しますと眼を痛めることがありますので、ご注意ください。
(There may be two important International specifications that should be noted for safe use of the LEDs: IEC 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems and IEC 60825-1:2001 (i.e. Edition 1.2) Safety of Laser Products - Part 1: Equipment Classification and Requirements. Ensure that when using the LEDs, there are no issues with the following points:
 - LEDs have been removed from the scope of IEC 60825-1 since IEC 60825-1:2001 (i.e. Edition 2.0) was published. However, depending on the country//region, there are cases where the requirements of the IEC 60825-1:2001 specifications or equivalent must be adhered to.
 - LEDs have been included in the scope of IEC 62471:2006 since the release of the specification in 2006.
 - Most Nichia LEDs will be classified as the Exempt Group or Risk Group 1 according to IEC 62471:2006. However, in the case of high-power LEDs containing blue wavelengths in the emission spectrum, there are LEDs that will be classified as Risk Group 2 depending on the characteristics (e.g. radiation flux, emission spectrum, directivity, etc.)
 - If the LED is used in a manner that produces an increased output or with an optic to collimate the light from the LED, it may cause damage to the human eye.)
- 点滅光を見続けると光刺激により不快感を覚えることがありますのでご注意ください。又、機器に組み込んでご使用される場合は、光刺激などによる第三者への影響をご配慮下さい。
(If an LED is operated in a manner that emits flashing light, it may cause health issues (e.g. visual stimuli causing eye discomfort). The system should be designed to ensure that there are no harmful effects on the human body.)

(10) その他 (Others)

- 本製品は、青色 LED にシリコンゴムが接着されております。 はんだ付け時や洗浄時等に接着部分へストレスがかからないように十分に注意して下さい。
(The content of this product is a blue LED with adhered silicone rubber. Precautions must be taken to prevent excess stress at the area of adhesion when soldering or cleaning.)
- 本製品は、ロット間及び同リール内(ロットコンバイン品)においてキャップの外観色に差異が生じる場合があります。しかし、光学特性は全数検査により保証されたものであり、使用上での問題はありません。また、必要に応じ外観承認見本を発行し取り交わしを行なうものとします。
(The rubber cap of these products has unique characteristics. A difference in appearance of color may be observed in a lot interval and on the same reel (product of lot combine) when unlit. However, the illuminated optical characteristics are guaranteed by total inspection of quality. Both parties shall exchange a boundary sample in appearance for authorization, as required.)
- 本製品の LED は、動作電流値により多少色調の変化があります。
(Illuminated color may shift somewhat depending on operating current.)

8. 保証 (Assurance)

- (1) 信頼性試験結果の項目及び条件内における納入品単体での保証と致します。ご使用に際して本仕様書記載内容条件を逸脱した使用状態で発生した事故/損傷に関しては、保証致しかねますのでご注意ください。
(Asahi Rubber warrants that the discrete LEDs will meet the requirements/criteria as detailed in the Reliability section within this specification. If the LEDs are used under conditions/environments deviating from or inconsistent with those described in this specification, the resulting damage and/or injuries will not be covered by this warranty.)
- (2) 本納入仕様書に記載してある事項について保証された品質の製品を納入致しますが、実機組み込み、実使用上での寿命その他の品質につきましては、貴社の責任で検証、確認のうえご使用いただきますようお願いいたします。
(Asahi Rubber warrants that the discrete LEDs manufactured and/or supplied by Asahi Rubber will meet the requirements/criteria as detailed in the Reliability section within this specification; it is the customer's responsibility to perform sufficient verification prior to use to ensure that the lifetime and other quality characteristics required for the intended use are met.)
- (3) 品質保証期間は、別途書面による合意がない場合、弊社が本製品を納入した日から 1 年間とします。
(Unless otherwise agreed in writing, the applicable warranty period is one year from the date that the LED is delivered.)
- (4) 本製品は、従来から LED が使用されている一般照明、家電製品、情報通信端末等の一般電子機器、及び自動車に使用されることを意図しており、特殊な用途(列車、船舶、航空機、宇宙船、海底中継機器、原子力制御システム、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、安全装置等)への使用を想定した設計も製造もいたしておりません。上記用途のような、特別な品質・信頼性が要求されるものについては、仕様書内に別に明記した場合を除き、弊社は、いかなる用途適性も保証いたしかねますのでご承知おきください。万が一、当該用途にご使用された結果、多大な財産侵害を招き、直接人命を脅かし、及び/又は人体に危害を及ぼすこととなった場合、弊社に一切の責はないものとします。
(This LED is intended to be used for general lighting, household appliances, electronics devices (e.g. mobile communication devices) and automobiles; it is not designed or manufactured for use in applications that require safety critical functions (e.g. aircraft, combustion equipment, life support systems, nuclear reactor control system, safety devices, spacecraft, submarine repeaters, traffic control equipment, trains, vessels, etc.). If the LEDs are planned to be used for these applications, unless otherwise detailed in the specification, Asahi Rubber will neither guarantee that the LED is fit for that purpose nor be responsible for any resulting property damage, injuries and/or loss of life/health.)

9. 不良品の処置 (Treatment of Defective Products)

甲において不具合のある製品(以下不良品という)が発見されたときは、以下に定める所により処理します。

(In the event that the LED is found not to conform to the foregoing specifications within the foregoing warranty period, Asahi Rubber will be subject to the procedure set forth below:)

- (1) 不良品が発見された場合、双方協議の上その措置を講ずるものとしますが、当該不良品が乙の責に帰すべきことが明らかな場合、代替品を納入致します。それ以上の責につきましてはご容赦下さい。
(Asahi Rubber will provide the replacement for the non-conforming LED or an equivalent item at Asahi Rubber's discretion, provided that the customer (1) promptly notifies Asahi Rubber in writing of the details of the non-conformity, (2) ships the non-conforming LED at the customer's expense to Asahi Rubber for examination, and (3) the non-conformity is specifically attributable to Asahi Rubber and not due to mishandling or misuse by the customer.)
- (2) 前項において不良品を返却する場合は、不良現象を明記した書面(不良内訳書)を添付して下さい。乙はその内容を速やかに検討し、検討結果を甲に連絡するものとします。
(The customer will provide Asahi Rubber with detailed written information on the non-conformity when returning the LED. Once Asahi Rubber has received both this information and the non-conforming LED, Asahi Rubber will conduct a thorough investigation to provide the customer with feedback.)

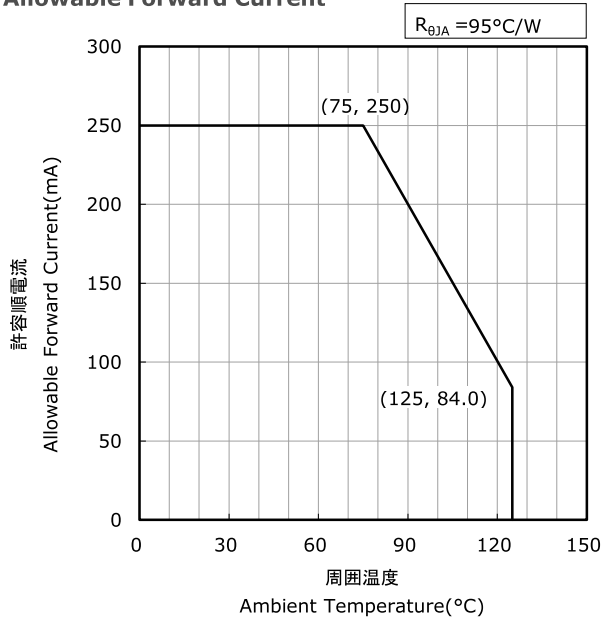
10. その他 (Others)

- (1) 甲乙間の品質に関する取り決め事項は、本仕様書に記載されている事項が全てであり、受領以前に取り交わされた取り決め事項のうち、本仕様書に記載されていない事項は全てその効力を失効するものとします。
(The warranties of quality set forth herein are exclusive. All previous negotiations and agreements not specifically incorporated herein are superseded and rendered null and void.
ASAHI RUBBER DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.)
- (2) 本仕様書の内容に不都合が生じた場合には、甲と乙は紳士的な協議により対処するものとします。
(This specification may be amended by gentleman's agreement between buyer and seller should the stipulations herein be insufficient or inappropriate.)
- (3) 弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を行わないで下さい。万一本製品に不具合が発見された場合は、本製品自体の解体をすることなく弊社まで直接連絡下さい。
(Without prior written permission from Asahi Rubber, the customer will not reverse engineer, disassemble or otherwise attempt to extract knowledge/design information from the LED. In the case of any incident that appears not to conform to the foregoing specifications, the local Asahi Rubber sales representative should be notified to discuss instructions on how to proceed while ensuring that the LED in question is not disassembled or removed from the PCB if it has been attached to the PCB.)
- (4) 本仕様書は甲乙いずれかの発意の後、両社が文書によって合意した事項に限り変更できるものとします。
(An amendment to the content of this specification may be made only in accordance with a prior written agreement between both parties.)
- (5) 本仕様書受領の記録として、受領印を押印のうえ弊社までご返却いただきますようお願い申し上げます。本仕様書発行後、3週間以内に書面による異議の申し出がない場合、受領印押印がなくとも本仕様書は受領されたものと判断します。
(To indicate customer's acceptance of the content of this specification, Asahi Rubber respectfully requests that the customer place its signature on the prescribed page of this specification and return it to Asahi Rubber. If the customer does not raise any objection within three weeks after the customer's receipt of this specification, the customer will be deemed to have accepted the terms and conditions written in this specification even without the customer's signature.)

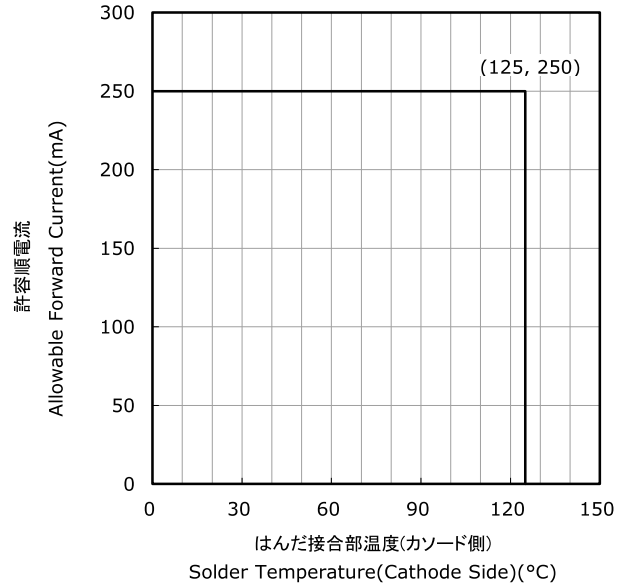
DERATING CHARACTERISTICS

NFSx172x
管理番号 No. STS-DA7-10214A

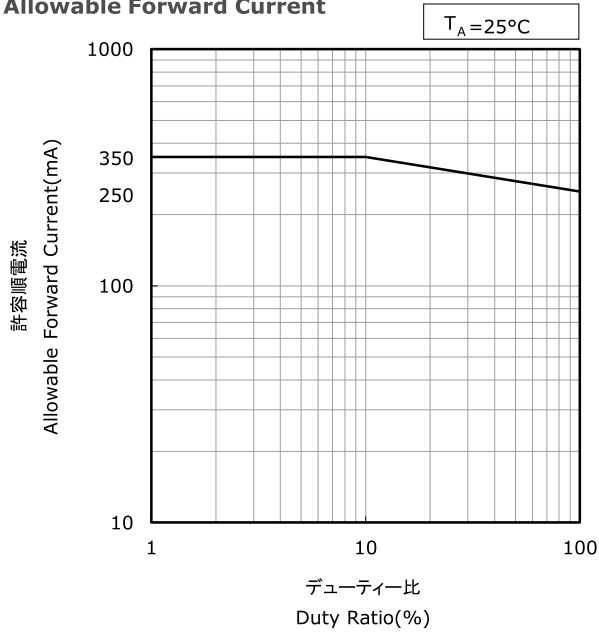
周囲温度-許容順電流特性
Ambient Temperature vs
Allowable Forward Current



はんだ接合部温度(カソード側)-許容順電流特性
Solder Temperature(Cathode Side) vs
Allowable Forward Current



デューティー比-許容順電流特性
Duty Ratio vs
Allowable Forward Current

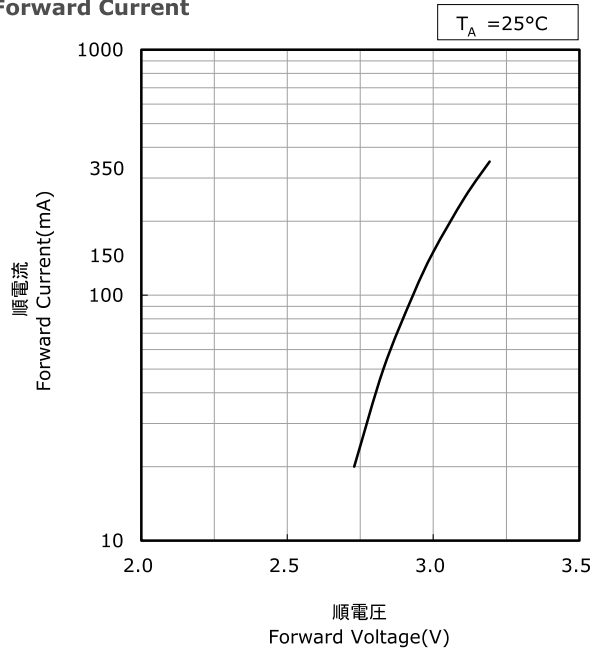


FORWARD CURRENT CHARACTERISTICS / TEMPERATURE CHARACTERISTICS

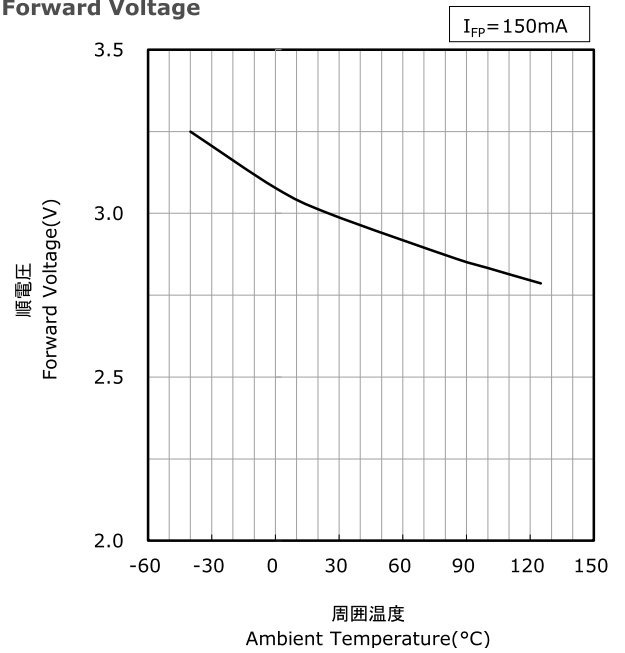
* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.

NFSC172C
管理番号 No. STS-DA7-15283A

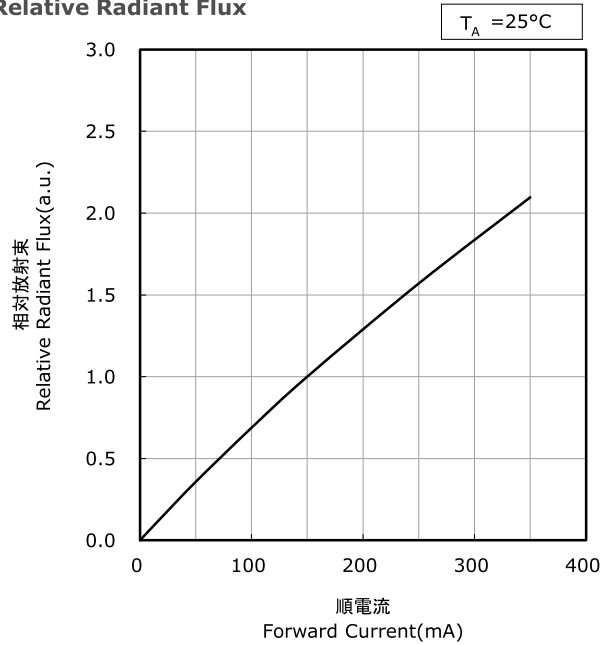
順電圧-順電流特性
Forward Voltage vs
Forward Current



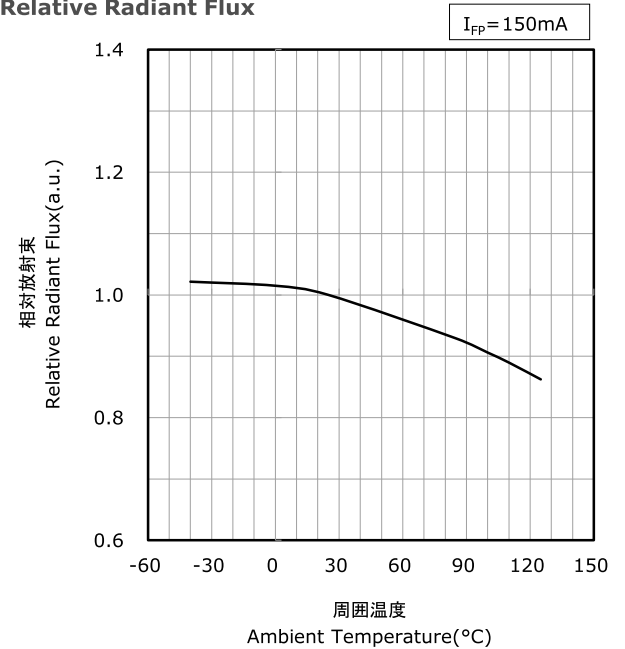
周囲温度-順電圧特性
Ambient Temperature vs
Forward Voltage



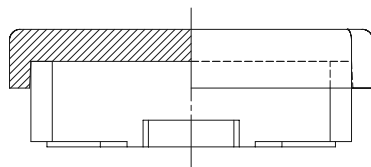
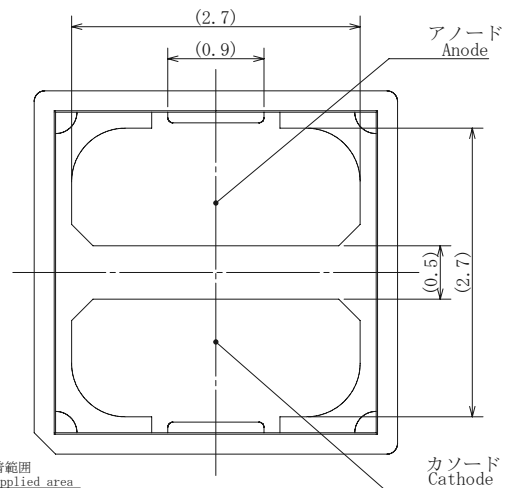
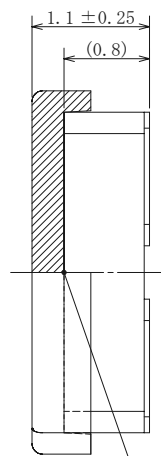
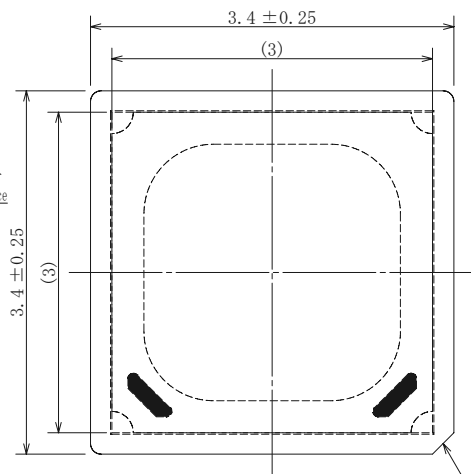
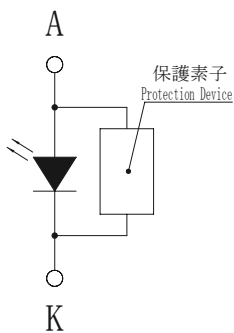
順電流-相対放射束特性
Forward Current vs
Relative Radiant Flux



周囲温度-相対放射束特性
Ambient Temperature vs
Relative Radiant Flux



内部回路図
Inside circuit diagram



カソードマーク
Cathode Mark
(C0.2)

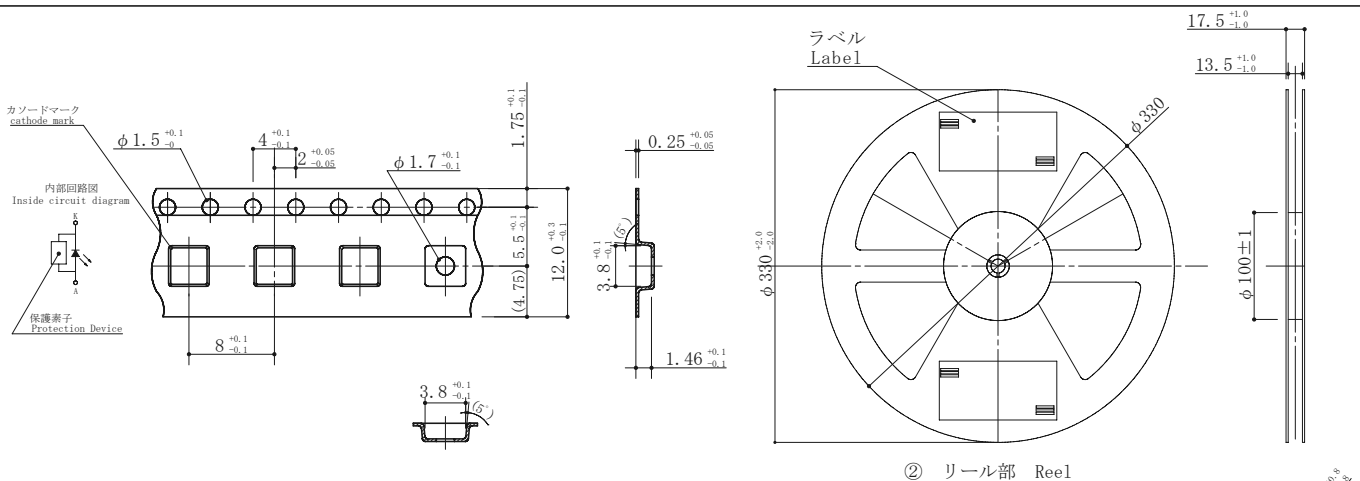
接着範囲
Adhesive applied area

項目 Item	内容 Description
シリコン ラバー キャップ Silicone rubber CAP	シリコンゴム (YAG蛍光体入り) Silicone rubber (with YAG phosphor)
接着剤 Adhesive	シリコン系 Silicone rubber
LEDパッケージ材質 Package Materials	セラミックス Ceramics
LED封止樹脂材質 Encapsulating Resin Materials	シリコン樹脂 (拡散剤入り) Silicone Resin (with diffuser)
電極材質 Electrodes Materials	金メッキ Au-plated

- *1 本製品には静電気に対する保護素子が内蔵されています。
Nxxx172xx-XX has a zener diode built in as a protection circuit against static electricity.
- *2 指示無き寸法公差は、±0.25mmとする。
- *3 括弧で囲まれた寸法は参考値です。
TOLERANCE : ±0.25mm
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.

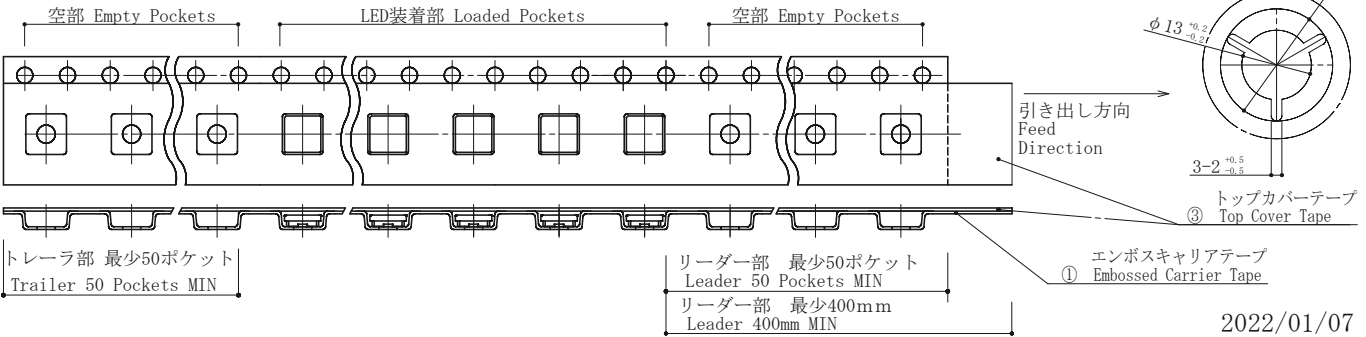
設計 Design	S. Tonegawa
確認 Checked	Y. Orikasa
承認 Approved	E. Ishiguro
日付 Date	2022/01/07
尺規 SCALE	20:1
単位 UNIT	mm

名称 Title	外形寸法 OUTLINE DIMENSIONS
図番 P/N	Nxxx172x-xxxx
株式会社 朝日ラバー ASAHI RUBBER INC	



② リール部 Reel

トレーラ部/リーダ部 Trailer and Leader

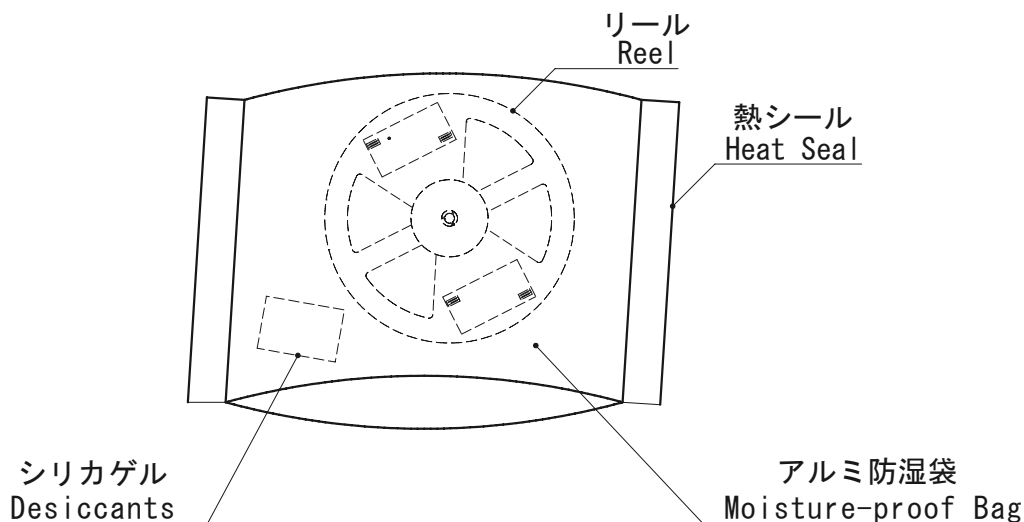


2022/01/07

*数量は1リールにつき5,000個入りです。
Quantity per reel=5,000pcs
* JIS C 0806電子部品テーピングに準拠しています。
The tape packing method complies with JIS C 0806
(Packaging of Electronic Components on Continuous Tapes).

項目	Item	材料	Material	LED Cap Assy Taping			
①	Carrier Tape	PS (Antistatic)		名称	テーピング仕様図 Taping Dimensions		
②	Reel	PS		図番	Nxxx172x-xxxx		
③	Cover Tape	PET (Antistatic)		P/N			
尺度	2 : 1	サイズ	A4	第三角法	保証	単位	mm
				Third-angle system			
作成	S. Tonegawa	検認	Y. Oriokasa	承認	E. Ishiguro		
					株式会社 朝日ラバー		
					ASAHI RUBBER INC.		

シリカゲルとともにリールをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。
Reels are shipped with desiccants in heat-sealed moisture-proof bags.



基本梱包単位
Packing unit

	リール数 Reel	チップ个数 Quantity/bag
アルミ防湿袋 Moisture proof foil bag	1 reel	5,000

梱包箱 (ダンボール) Cardboard box	箱の寸法 (mm) Dimensions (mm)	リール数 Reel/box	チップ个数 Quantity/bag
梱包箱 M Cardboard M	380×380×130	6 reel MAX	30,000 MAX
梱包箱 L Cardboard L	380×380×260	13 reel MAX	65,000 MAX

ラベル Label

①	
②	
③	
④	⑤
⑥	
⑦	

- ①: 品番 Part No.
②: 品名 Description
③: 数量 Quantity
④: 顧客コード CD
⑤: 出荷ロットNo. Lot No.
⑥: 備考欄 Remarks column
(注文No. Order number)
⑦: 会社名 Company name
((株) 朝日ラバー , ASAHI RUBBER INC.)

2022/01/07

図名 Title	梱包仕様図 Packing specifications
図番 P/N	Nxxx172x-xxxx
株式会社 朝日ラバー ASAHI RUBBER. INC.	